MEMS マイク

**TDKがSoundWire™機能を備えた最新のMEMSマイクロフォンを発表**

* MIPI SoundWire™準拠の新しいMEMSマイクロフォンT5828
* 常時オンの超低電力モードを備えたSNR 68dBAおよびAcoustic Activity Detect機能を提供

2022年1月6日

TDK株式会社（社長：石黒　成直）は、モバイル、TWS、IoTをはじめとするコンシューマー向けデバイスを対象とした、高性能のSmartSound™ファミリーの新製品として、T5828 SoundWire™ MEMSマイクロフォンを発表しました。高度な機能を小さなパッケージに集積したSmartSoundファミリーの高性能マイクロフォンは、マイクロフォンの音響性能の限界を押し上げます。T5828 SoundWire™ MEMSマイクロフォンは、133dB SPLという優れたアコースティックオーバーロードポイント（AOP）、68dBAの高SN比（SNR）、広いダイナミックレンジを実現しており、非常に静かな環境から大音量までに最適です。

T5828マイクロフォンの特長

* 非常に低電力でダイナミックレンジの広いSoundWire™ Digital
* SoundWire™マイクロフォンに初めてAcoustic Activity Detect（AAD）を搭載し、非常に低電力の20µA汎用アクティビティ検出から高度に設定可能な音声アクティビティ検出機能など、SoundWire制御プロトコル内での設定が簡単になります。
* 既存の高品質モードと低電力モード内に新しいサブモードが追加され、次のようなマイク性能の動的なカスタマイズが可能になりました。
  + 136dBのSPLの拡張AOPモード
  + 95µAの超低電力モード（PDMマイクロフォンで初めて100µA未満の低電力を実現）

TDK InvenSenseで、プロダクトマネジメント担当バイスプレジデントを務めるRitesh Tyagiは、次のように述べています。「TDKは、最先端のSoundWire™ MEMSマイクロフォン、T5828の投入によって、SoundWire™エコシステムをさらに拡張しました。Qualcomm社とのパートナーシップにより、SoundWire™の優れた機能をシンプルな2線式インターフェースで提供できるようになっています。最大11のオーディオデバイス、双方向の音声データストリームに加え、他社のデジタルインターフェースと比べても極めて機能性に優れた制御インターフェースが実現しました」

TDK T5828は3.5 x 2.65 x 0.98 mmの小型のボトムポートパッケージでサンプルを準備しております。詳細については、[sales@invensense.com](mailto:sales@invensense.com)にお問い合わせいただくか、<https://invensense.tdk.com/smartsound/>をご覧ください。TDKは2022 CES Virtual Press ConferenceにもT5828を出展します。詳しくは[pr@invensense.com](mailto:pr@invensense.com)までお問い合わせください。

-----

用語集

* TWS: True Wireless Stereo
* HQM: High Quality Mode
* LPM: Low Power Mode
* AOP: Acoustic Overload Point
* SNR: Signal to Noise Ratio
* SPL: Sound Pressure Level
* AAD: Acoustic Activity Detect

主な用途

* スマートフォン
* TWSイヤホン
* タブレット
* カメラ
* Bluetoothヘッドセット
* スマートスピーカー
* ノートPC
* セキュリティ、監視

主な特長と利点

* SoundWireインターフェース
* SNR 68dBA
* 136dBのSPLの拡張AOPモード
* 95µAの超低電力モード（PDMマイクロフォンで初めて100µA未満の低電力を実現）
* 3.5 x 2.65 x 0.98 mmの小型のボトムポートパッケージ

主な特性

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **製品名** | **パッケージ寸法（mm）** | **SNR dBA** | **アコースティックオーバーロードポイントdB SPL（HQM / EAOPM）** | **Power µA**  **（ULPM / LPM / HQM）** | **LFRO** | **インターフェース** |
| **T5828** | 3.50 × 2.65 × 0.98 | 68 | 133 / 136 | 95 / 130 / 330 | 35 | SoundWire |

-----

**TDK株式会社について**

　TDK株式会社（本社：東京）は、スマート社会における電子デバイスソリューションのリーディングカンパニーを目指しています。 独自の磁性素材技術をそのDNAとし、最先端の技術革新で未来を引き寄せ（Attracting Tomorrow）、社会の変革に貢献してまいります。

当社は各種エレクトロニクス機器において幅広く使われている電子材料の「フェライト」を事業化する目的で1935年に設立されました。主力製品は、積層セラミックコンデンサ、アルミ電解コンデンサ、フィルムコンデンサ、インダクタ、フェライトコア、高周波部品、ピエゾおよび保護部品等の各種受動部品をはじめ、温度、圧力、磁気、MEMSセンサなどのセンサおよびセンサシステムがあります。さらに、磁気ヘッドや電源、二次電池などです。これらの製品ブランドとしては、TDK、EPCOS、InvenSense、Micronas、Tronics、TDK-Lambdaがあります。

アジア、ヨーロッパ、北米、南米に設計、製造、販売のネットワークを有し、自動車、産業電子機器、コンシューマー製品、そして情報通信機器など幅広い分野においてビジネスを展開しています。2021年3月期の売上は約1兆4790億円で、従業員総数は全世界で約129,000人です。

-----

本文および関連する画像は<https://www.tdk.com/ja/news_center/press/20220106_05.html>. からダウンロードできます。

製品の詳細情報は <https://www.invensense.tdk.com/technology/smartsound/>. で参照できます。

-----

**報道関係者の問い合わせ先**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| * **担当者** | * **所属** | * **電話番号** | * **Email Address** |
| * 大須賀 | * TDK株式会社 * 広報グループ | * +81 3 6778-1055 | * [pr@jp.tdk.com](mailto:pr@jp.tdk.com) |